

# SI8230A/B

## 导热阻燃灌封胶

Premium Quality & Ultimate Service

### SI8230A/B双组份导热阻燃灌封胶

#### ■ 技术参数

测试项目	测试标准	A 组分	B 组分
外观	目测	白 or 黑色粘稠液体	白色粘稠液体
粘度,cps , 25°C	GB/T 10247-2008	2500±500	2300±500
比重,g/cm3, 25°C	GB/T 15223-1994	1.52±0.03	1.52±0.03
混合比	质量比	A: B = 100: 100	
混合后粘度,4#转子,cps , 25°C	GB/T 10247-2008	2500±500	
混合后操作时间,分钟 , 25°C	GB/T 10247-2008	50±10	
混合后表干时间,分钟, 25°C	GB/T 10247-2008	90±20	
硬化条件	GB/T 10247-2008	25°C/3-5 hr 或 80°C/ 30mins	
<b>固化后特性</b>			
硬化物外观	目测	灰色 or 白色 or 黑色, 柔韧弹性体	
硬度, Shore A	GB/T 531-2008	55±5	
导热系数, W/mK	GB/T 10297-1998	0.65±0.03	
线性膨胀系数, K-1, ppm	HGT 2625-1994	230	
介电强度,kV/mm, 25°C	GB/T 1695-2005	≥15	
体积电阻,DC 500V, Ω·CM	GB/T 1692-92	1.1×10 <sup>15</sup>	
损耗因素(1 MHz)	GB/T 1693-2007	0.009	
介电常数(1 MHz)	GB/T 1693-2007	3.00	
温度范围, °C	GBT 20028-2005	- 60 ∞ 200	
耐燃性	UL-94	V-0	

PS: 操作时间及固化时间是以配胶量 100g 来测试的。

固化状态所有数据都在 25°C、55%RH 条件下胶固化 7 天后测定所得。

#### ■ 产品描述

**SI8230 A/B** 是一种双组分有机硅导热灌封胶, 经混合后具有很好的流动性, 操作时间可根据温度调整, 室温可深层固化, 适用各种散热耐温元件的灌封保护, 完全符合欧盟ROHS指令以及SVHC REACH要求。

#### ■ 应用领域

- ◇ 汽车电子、模块
- ◇ LED 电源驱动模组
- ◇ 太阳能组件接线盒
- ◇ 电动车充电柱模块
- ◇ 锂电池组、电容组

# SI8230A/B

## 导热阻燃灌封胶

Premium Quality & Ultimate Service

- ◇ 磁感线圈
- ◇ 逆变电源

### ■主要特性

- ◇ 双组分加成型硅橡胶
- ◇ 1: 1混合比例
- ◇ 低硬化收缩率
- ◇ 优异的高温电绝缘性、稳性定
- ◇ 良好的防水防潮性
- ◇ **优异的阻燃性 UL No: E340199**

### ■包装规格

- ◇ SI 8230W 白色有机硅导热灌封胶, code: A0105012/B0105013
- ◇ SI 8230B 黑色有机硅导热灌封胶, code: A0105028/B0105029
- ◇ SI 8230G 灰色有机硅导热灌封胶, code: A0105080/B0105081
  
- ◇ A 组分: 20 kg/塑料桶  
B 组分: 20 kg/塑料桶
- ◇ A 组分: 250 kg/塑料桶  
B 组分: 250 kg/塑料桶

### ■储存及运输

- ◇ 本产品需在 35°C 以下的阴凉干燥环境中贮存, 在 25°C 以下贮存期为 1 年。
- ◇ 此类产品属于非危险品, 可按一般化学品运输, 小心在运输过程中泄漏。
- ◇ 超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。
- ◇ 贮存过程中可能产生少许沉降分层, 搅拌均匀后使用不影响性能。

为减少沉降严重结块, 须定期翻转倒置储存的物料, 建议一个月翻转一次。

### ■注意事项

- ◇ 对混合后 A/B 组分真空脱泡可提高硬化产品性能
- ◇ A、B 组分取用后应密封保存
- ◇ 温度过低会导致固化速度偏慢, 温度过高会导致固化速度偏快, 建议车间恒温
- ◇ SI8230 与含硫、胺、有机锡、不饱和烃类增塑剂等材料接触会难以硬化, 常见物质有松香、天然橡胶, 使用前须先测试。
- ◇ 产品的数据是在 25°C 恒温环境下测试, 其他低温或高温的环境中使用请先测试。如有异常请咨询求助相关销售人员。

### ■操作工艺

- ◇ 施胶之前将 A、B 组分在各自包装中搅拌均匀, 这是因为胶料在贮存过程中, 其中的填料可能会部分沉降。
- ◇ 将 A、B 组分按 1: 1 的比例称量, 混合均匀, 直接注入需灌封保护的元器件 (或模块) 中。最好顺着器壁的一边慢慢注入, 可减少气泡的产生。
- ◇ 将灌封好的元件静置, 让其自行排泡, 气泡基本消失后可加温固化, 亦可直接在室温条件下固化, 大约需要 5hr。
- ◇ **需要定量灌胶的灌封设备请咨询我公司市场部。**

# SI8230A/B

## 导热阻燃灌封胶

### ■ 安全操作资料

这里不是完全的产品安全资料。在使用前，请注意阅读产品资料、产品安全资料及包装标签以便安全使用。产品安全资料可以从 MAXTECH 及各分销商处获得，也可以写邮件给 MAXTECH 服务中心 MAXTECH@SHMAXTECH.COM。

### ■ 质量保证书—请仔细阅读

我们保证这里所包含的产品性能、使用信息都是准确而可靠的。但是，您在使用之前还是应对其性能、安全使用等方面进行测试。应用的建议不能视为在任何状态下都适用。